

先端半導体パッケージの3D実装技術

2022年1月28日（金） 13:30～16:20

Zoom Webinar
ON-LINE開催

共催:

大阪大学F3D実装協働研究所
経済産業省 近畿経済産業局

後援:

一財)大阪大学産業科学研究協会 一社)日本電気計測器工業会(JEMIMA)
一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP) 一社)電子情報技術産業協会(JEITA)

13:40～14:30 部品メーカーの内蔵基板技術(SESUB)と接合技術

一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP) 土門 孝彰 氏

【概要】材料・部品の開発をメインとする製造メーカーは、最終製品の性能に左右される場合が多い。そんな中、独自の材料、要素技術面の優位性を生かしてハードシステムへ決定的な価値を与えICと受動素子のハイブリッド内蔵技術(FO-WLP like なヘテロジニアスモジュール)の一端を紹介する。



14:40～15:30 複雑化する半導体設計に対応した接合材料

千住金属工業株式会社 研究開発部 大田 健吾 氏

【概要】爆発的に増加する情報通信量へ適応する為、Key Deviceである半導体の設計には微細化、積層化に加え放熱性や信頼性の向上が求められている。接合材料の観点から、これらの課題を解決する材料の提案を行う。



15:30～16:20 半導体産業の変化とチャンス

株式会社東芝 CPSxデザイン部 大幸 秀成 氏

【概要】半導体デバイスの需要は年間60兆円に及び、今後も成長が続きます。ところが現在、長期的な供給問題が発生しており、その原因を解説します。更にこれからの日本半導体産業の目の付け処を紹介します。



※公開講座内容について、都合により一部変更になる可能性があります。ご了承ください。

お問合せ

大阪大学フレキシブル3D実装協働研究所
http://www.f3d.sanken.osaka-u.ac.jp/
MAIL f3d@sanken.osaka-u.ac.jp
TEL 06-6879-4295 (平日 9:00-17:00)

お申込み

- 1)WEBからのお申込み：
<https://forms.gle/a8gaPYKPLCHxLw887>
- 2)メールからのお申込み：
f3d@sanken.osaka-u.ac.jp



※メールでお申込みの際は、お名前・ご所属・住所及びZoom接続可能メールアドレスをご記入下さい。